



机械设备行业周报：下游扩产提速 半导体键合机国产化值得期待



一周市场回顾:本周 SW 机械板块上涨 1.45%, 沪深 300 上涨 2.52%。

通用设备仍是市场关注和博弈的焦点, 位置低、筹码结构好, 低基数下同比数据改善等逻辑支撑本轮通用设备反弹, 建议重点关注低估值的叉车、刀具等环节; 锂电设备在新能源汽车需求边际放缓的背景下估值持续承压; 光伏设备机构持仓相对拥堵, 基本面仍无忧, 建议等待调整时机。

每周增量视角: 半导体行业景气回升, 键合机国产替代空间广阔。随着物联网、大数据、人工智能、5G 通信等新型应用市场的加速发展, 芯片增量需求推动封装设备市场规模增长, 2021 年国内半导体市场规模达 296.2 亿美元, 同比增长 58.23%。引线键合是半导体封测工艺的重要环节, 但相比于其他封测设备, 引线键合机国产化率仍较低, 主要系我国的引线键合机开发起步晚, 需突破的技术门槛较多。

根据百孚观察, K&S、ASMPT 和 Kaijo 等国际领先厂商占据超 95% 的市场份额。随着下游封测厂商加速扩产, 多轮政策支持下, 键合机市场格局将进一步向国内厂商倾斜。据 SEMI 统计, 封装设备价值量在半导体设备中占比约 6%, 其中, 键合机占封装设备市场规模的 32%。我们预计, 下游需求拉动下, 2024 年我国键合机市场空间达 14.2 亿美元。随着国产化率的逐步提升, 2024 年国产化率达 12% 的乐观估计下, 我国国产键合机市场空间有望达 1.71 亿美元。建议关注涉及半导体键合机业务的 A 股上市公司奥特维、大族封测、凯格精机、骄成超声、新益昌等。

本周核心观点: 自动化: 国内工业机器人 2022 年 10 月工业机器人产

量 3.9 万台, 同比增长 14.4%, 疫情影响下制造业投资相关链条持续承压, 下半年在低基数效应下相应公司盈利能力或延续改善, 建议关注刀具厂商欧科亿、华锐精密、国茂股份、绿的谐波等; 激光: 受国内疫情影响, 激光行业需求承压, 行业高功率化趋势持续, 6000w 以上高功率产品有望持续放量, 建议关注国产激光切割运控系统龙头柏楚电子以及价格竞争后续有望改善的国产激光器龙头锐科激光; 光伏设备: 行业降本提效是主旋律, 全球光伏平价背景下硅片、电池片到组件环节扩产规模有望超预期, 建议关注平台化布局的硅片组件设备龙头晶盛机电、奥特维; 电池片环节, 金属化方面, 激光转印技术下半年有望放量, 建议关注帝尔激光; 异质结进展有望超预期, 后续单 W 成本与传统 PERC 有望打平, 建议关注迈为股份; 锂电设备: 据中汽协数据, 国内新能源汽车 2022 年 10 月产量 75.2 万辆, 同比增长 84.8%, 全球电动化浪潮明确, 大客户订单兑现在即, 建议关注其对工艺设备龙头的弹性, 具体包括先导智能、杭可科技等, 除此之外下游动力电池竞争以及产品迭代带来新增工艺设备需求, 建议关注奕瑞科技、东威科技等; 检测&计量: 中长期制造业升级带动第三方检测需求持续增长, 行业马太效应显著, 二季度受疫情影响略有承压, 建议关注苏试试验、

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_49832

